



RoHS

Monitor nie stanowi elementu standardowego wyposażenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Sterowanie w pętli zamkniętej i równomierny rozkład ciepła jest realizowany za pomocą czujnika podczerwieni badającego całą powierzchnię BGA.
- Kamera RPC dba o prawidłowość przebiegu procesu, pozwalając dokładnie monitorować topnienie lutowni.
- Łączność z PC oraz program do zapisu przebiegu procesu lutowania.
- Stacja BGA na podczerwień zapewniająca najlepszą jakość procesowi reballingu dzięki wyeliminowaniu przepływu powietrza i mniej skutecznym dysz.
- Skrócony czas oraz wysoka precyzja lutowania dzięki zastosowaniu promiennika na "ciemną" podczerwień typu otwartego. Co wpływa też pozytywnie na rozkład pionowy temperatury na obrabianym elemencie BGA.
- Element PCB może być przemieszczany w czterech kierunkach.

SPECYFIKACJA

IR EA-H00

Moc całkowita	2400W (max)
Moc grzania (z góry)	6´120W=720W promienniki IR długość fali 2~8µm
Czas grzania (z góry)	Do 10 sekund
Moc grzania (z dołu)	4´400W=1600W promienniki "dark" IR lub 4´500W=2000W IR
Wymiary podgrzew. dolnego	290 ´ 290 mm
Zakres reg. podgrzew. górnego	20~60mm (osie X,Y regulowane)
Max wymiar płytki	400 ´ 400mm
Komunikacja	USB z PC
Czujnik temperatury	Bezkontaktowy czujnik IR
Wymiary stacji (szer ´ gł ´ wys)	850 ´ 650 ´ 730 mm
Masa	40 kg
RPC Kamera obserwacji procesu lutowniczego	
Kamera	Powiększenie 22´10
Rozdzielczość pozioma	480 linii; PAL system

